

成都成电光信科技股份有限公司

关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、综合授信基本情况概述

为满足生产经营资金需要，公司 2026 年度拟向银行继续申请合计不超过 3.8 亿元综合授信额度，授信由公司 3 位实际控制人（以银行最终审核要求为准）无偿提供连带责任保证担保。授信形式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函（投标、履约、质量、预付款）、商票贴现、商票保贴、应收账款无追索权明保理等，最终以银行实际审批为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，公司与上述银行实际发生的融资金额应在授信额度内，公司可以根据实际资金需求在不同授信银行之间调剂使用，具体融资金额、品种、期限、利率、用途及相关权利义务关系以公司与银行签订的合同为准。

公司授权法定代表人及公司管理层全权办理银行授信及后续提用相关工作，由公司法定代表人全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切与授信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

二、审议和表决情况

2026 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议并表决通过了《关于预计 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

三、对公司的影响

公司本次申请银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司经营所需资金，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

四、备查文件目录

《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日